



正當全球籠罩在一片經濟不景氣中，製造業首當其衝，各大企業紛紛積極尋找相關對策減少公司支出成本，來改善獲利和成長。面對這種考驗，製造業該如何逆勢成長？

基於協助台灣製造業進行技術升級以渡過此經濟風暴為目的，科盛科技將於 2009 年 3 月中旬，與台灣科技大學和遠東科技大學等共同舉辦 Moldex3D R9.1 創新技術研討會，希望能透過多位專家學者的知識與經驗分享，讓您了解如何透過設計與製造能力的提升，降低量產成本、縮短成形週期、控制翹曲變形、提昇產品設計力與模具競爭力，挑戰 2009 年不景氣，逆勢增加企業獲利！

■ **主辦單位**：科盛科技股份有限公司      ■ **協辦單位**：台灣科技大學、遠東科技大學      ■ **報名費用**：免費

■ **活動時間**：3/10(二)台北場、3/12(四)台南場、3/17(二)新竹場、3/19(四)台中場，13:00~17:30

■ **活動地點**：台北-台灣科技大學(國際大樓)、台南-遠東科技大學(國際會議廳)

新竹-竹北台元科技園區一期會館(2F 多功能會議室)、台中-東海大學(省政大樓中會議廳)

■ **聯絡資訊**：聯絡窗口：曾先生 03-5600199 ext.703 / e-mail : [mkt@moldex3d.com](mailto:mkt@moldex3d.com)

■ 凡參加本活動之來賓除可獲得主辦單位精心準備之精美贈品，還有機會獲得

Wii、iPod 系列產品、ASUS 藍牙衛星導航、數位像框和隨身硬碟...等多項大獎

■ 活動詳情請洽 Moldex3D 網站：<http://www.moldex3d.com/ch/>



Moldex3D® Moldex3D R9.1 創新技術研討會 報名表 (傳真報名 Fax: 03-5600198)

公司名稱				電話	
公司地址				傳真	
姓名	部門	職稱	分機	電子信箱	
報名場次	3/10(二)台北場	3/12(四)台南場	3/17(二)新竹場	3/19(四)台中場	
訊息來源	Moldex3D 網頁	Moldex3D 電子報	業務邀請函	其他單位邀請函	

■ 研討會議程表：

時間	場次	講師	演講單位/ 職稱
13:00~13:20	來賓報到		
13:20~13:30	開幕儀式		
13:30~14:30	<b>2009 年製造業挑戰與契機：</b> <b>Moldex3D R9.1 協助企業降低成本提昇技術強化競爭力</b> ■ R9.1 五大技術升級，包含計算效能升級、分析精準度升級、使用便利性升級、CAD/CAE 整合性升級、以及資源管理能力升級 ■ 如何利用此新模流技術，降低生產成本、縮短成形週期、控制翹曲變形、提昇產品設計力與模具競爭力	楊文禮 博士	科盛科技/ 總經理
14:30~15:00	<b>光學元件射出成形技術與分析</b> ■ 光學元件之分類與應用 ■ 結構光學元件射出成形技術 ■ LED 光學元件射出成形技術	陳炤彰 教授	台灣科技大學/ 產學合作中心 主任
15:00~15:20	Coffee Break		
15:20~16:50	<b>體驗十倍速模流分析快感-Live Demo</b> ■ 快速澆口設計與分析展示 ■ 快速流道與水路設計展示 ■ 10 倍速真實三維分析展示	-	科盛科技
15:50~16:30	<b>最新全球模流分析產業應用之精選案例分享</b> ■ 看歐美日韓國際大廠如何善用模流分析改善品質與控制成本 ■ 分享新成型技術應用，包含多材質射出、殘留應力、可變模溫...等 ■ 分享新產業個案應用，包含 3C、汽機車、光電、生醫、消費性產品...等	楊文賢 博士	科盛科技/ 技術研發部 協理
16:30~17:10	<b>下世代模流分析發展願景與展望</b> ■ CAE 模流分析現在、過去與未來 ■ 無縫式 CAD & CAE 整合式工作平台，設計與分析流程一條龍，提高模具開發效率 ■ 多元化 CAE 整合方案，全面解決產品設計、模具開發至商品量產各種面向的問題 ■ 高效能遠端計算科技，最大化企業分析資源，提高人員工作效能	許嘉翔 博士	科盛科技/ 研發部 副總
17:10~17:30	幸運抽獎活動		

